

平成27年度 ナノテクキャリアアップアライアンス
京都大学 電子線描画装置アドバンスコース《短期型》

■目的、対象者：

最先端の半導体やMEMSデバイスにおいて、微細な配線や構造が必要となってきています。これらの微細配線や構造を作製するためのキー技術となっているのが、nmオーダの微細パターンを描画できる電子線描画装置です。

本コースにおいては、微細加工の中級者を対象にし、CADによる描画パターン設計、最新鋭電子線描画装置によるSiウェハ（酸化膜付）への高度な描画（多層レジスト、重ね合わせ描画）を行い、より複雑なデバイス加工が可能となる電子線描画技術の習得を目指します。

■募集人数： 5名（最大）

■期間： 平成28年3月7日（月）～3月16日（水）

講義：2日間（全員）、実習：2日間（個別） 合計4日間

■会場： 京都大学ナノテクノロジーハブ拠点

■内容：

1日目、2日目 3月7日（月）、8日（火）

① 電子線描画の基礎から応用（講義） 参加者全員が対象

*）以下の日程は受講者毎に連続した2日間を実施します。参加者により日程が異なりますのでご注意ください。具体的な受講日程は、受講決定後、調整します。

3日目 3月9日（水）or10日（木）or11日（金）or14日（月）or15日（火）

② CADによる描画パターンデータ作成

③ 露光前処理 -レジスト塗布等（実習）

④ 多層レジストを用いた描画（実習）

4日目 3月10日（木）or11日（金）or14日（月）or15日（火）or16日（水）

⑤ 高精度重ね合わせ描画（実習）

⑥ 描画パターンのSEM観察（実習）

■受講料：

アライアンス内の博士課程（後期）学生、若手研究者および研究支援人材：
無料（旅費の補助を予定）

一般：250,000円

■連絡先： 京都大学ナノテクノロジーハブ拠点

(kyodai-hub@saci.kyoto-u.ac.jp、電話：075-753-5231)